

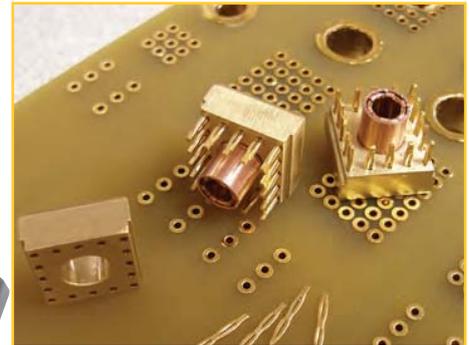
基板への大電流供給用「ラドソック パワーバス」コネクタ

最新の電子機器はプリント基板に大電流を供給する必要性が増えています。この一般的な解決方法は、プリント基板を追加したり、基板の銅層を厚くすることです。しかし、これは費用が嵩み、基板が熱を持つこともあります。基板上に通常のコネクタや配線で電流を供給する方法は、電線の束ね作業や圧着 / 半田、組立など大きな労力とコストがかかり、さらに多くの貴重な基板面積を使ってしまいます。これらの基板への大電流供給を解決する手段として、アンフェノールはラドソック技術を提案します。

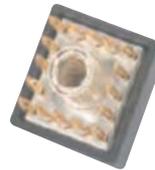
パワーブロック (PowerBlok™)

ラドソック パワーブロックは、3.0mmの標準ラドソック使用で基板に 70 アンペアまでの大電流を流せます。プレスフィットで基板に確実に接続します。

- ・ 3.0mm ラドソックで、70 アンペアまで対応
- ・ コンパクトな設置面積 約 12.7 x 12.7 mm
- ・ 特別な圧着工具は不要
- ・ タッチプルーフカバーによる保護
- ・ 基板へのストレス要因がなく、不具合が減少、過熱焼失も排除
- ・ 組立コストの軽減
- ・ RoHS 対応



約 12.7x12.7mm の小さなスペースに 3mm のラドソックを組み込み、大電流 70 アンペア対応



品番	パワーブロック (ラドソック) のサイズ	仕様
C10-639323-00	3.0 mm	プレスフィットピン仕様

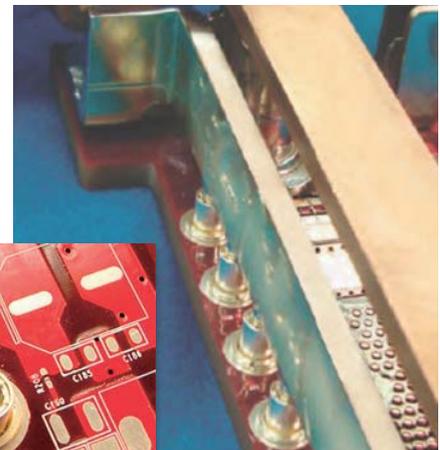
ラドサート (RADSSERT™)

プリント基板に最も強力な接続が必要な場合には、ラドサート をお選びください。

ラドサートは、基板や基板上の部品をまたいで取り付けられたバスバーから基板に電力供給する設計です。バスバーから伸びたピンコンタクトが、ラドサートに圧入されたラドソックコンタクトと嵌合します。

ラドサートは、プリント基板上のめっきされたスルーホールに圧入します。設置面積は、パワーブロック、ラドソック PGY と比較しても最小で、基板厚 6.35 ± 0.8mm用として、直径 2.4mm と 3.6mm の 2 種類のサイズがあります。

- ・ 小さなパッケージで基板に大電流を供給
- ・ 半田取付、又は一体型は基板製造時に装着
- ・ 2.4mm ラドサート 35 アンペアまで対応
- ・ 3.6mm ラドサート 70 アンペアまで対応
- ・ 基板のクラックや層間剥離の発生リスクを排除
- ・ RoHS 対応



ラドサート ラドソック

品番	パワーブロック (ラドソック) のサイズ	仕様	適合基板厚
C10-642495-241	2.4 mm	半田取付	6.35 ± 0.8 mm
C10-639772-001	2.4 mm	一体型、事前取付	
C10-642865-001	3.6 mm	半田取付、ショートタイプ	
C10-642449-001	3.6 mm	一体型、事前取付、ショートタイプ	